

SEMICON JAPAN 2022 出展のご案内

拝啓 貴社ますますご発展のこととお喜び申し上げます。
また平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、このたび「SEMICON JAPAN 2022」へ出展させていただく運びとなりました。
今回当社は Advanced Packaging and Chiplet Summit へ参画し、ブースでは最先端パッケージングへの最適なモールドング技術をご提案させていただきます。
ご多忙の折とは存じますが、何卒ご来場のうえご高覧賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

日時 : 2022年12月14日(水)～16日(金)

10:00～17:00

場所 : 東京ビッグサイト 東館

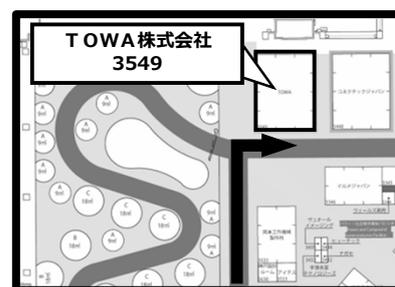
小間 : Hall 3 No.3549

備考 : ご来場には招待券が必要です。

下記特設HPよりご登録をお願いいたします。

HP : <http://www.towajapan.co.jp/jp/semiconjapan2022/>

特設HP



■ 展示内容

1 Advanced Packaging向け樹脂封止技術

最先端半導体に活用されるWLP/PLPプロセスに対し、高品質かつ生産性向上に貢献する当社のコンプレッションモールドング技術をご紹介します。

2 モバイル半導体向け樹脂封止技術

通信モジュールやセンサー・カメラなどのデバイスに対し、製品のダメージ軽減に貢献する低圧成形技術や多機能化を実現する両面成形技術をご紹介します。

3 車載半導体向け樹脂封止技術

パワー半導体やECUなどの車載デバイスに対し、信頼性向上・パッケージの小型化に貢献する一括成形技術や露出成形技術をご紹介します。

4 シングュレーション技術

小型から厚モノパッケージのカット、さらに成形前基板のカットまで幅広く対応可能な当社のシングュレーション技術をご紹介します。

5 レーザ技術

レーザを活用した溶接・切断・トリミング加工技術をご紹介します。

6 ラボラトリー・ものづくりサポート体制

試作・プロセス開発を行う当社ラボ設備から生産を支える多様なサービスまでお客様のお問い合わせから試作・量産まで一貫した安心のサポート体制をご紹介します。